

Yamato Denki Ind.Co.,Ltd.Suwa Plant

大和電機工業(株)諏訪事業所

〒392-0015 諏訪市中洲4750
4750 Nakasu, Suwa-shi 392-0015
TEL 0266 (58) 3353 FAX 0266 (53) 3396

(URL) <https://yamato-elec.co.jp/>



- 代表者 原 房利
- 資本金 9,000万円
- 創業年月 昭和19年4月
- 従業員 420人(全社)
- 工場規模 (諏訪事業所)敷地5,552.5㎡
建物4,870.1㎡
- 主な取得認証 IATF16949
ISO14001
ソニーグリーンパートナー

Representative: Fusatoshi Hara
Capital: 90 million yen
Established: April 1944
Employees: 420
Factory Size: Ground- 5,552.5㎡
Building Floorspace- 4,870.1㎡
(Suwa Plant)

- Operations:
1. Electro and Electroless precious metal plating for electrical circuits (PC board, LTCC, wafer, MEMS and etc.)
 2. Selective precious metal plating for lead frames.
 3. Various precious metal plating for electro devices and micro connectors.

主要加工品目及び加工内容

- (諏訪事業所)
- 1.電子基板(プリント基板、LTCC基板、ウエハ、MEMS等)への電解及び無電解貴金属めっき
 - 2.半導体リードフレームなどへの部分貴金属めっき
 - 3.電子部品、微細コネクタへの各種貴金属めっき

当社の特徴

当社は、電子部品を中心とする、実装、ボンディング用途に使用する機能めっき加工メーカーとして、長年培った基礎技術、開発研究をベースに、様々なマイクロエレクトロニクス分野に貢献しています。

諏訪事業所はプリント基板、半導体ウエハ、LTCC基板、リードフレーム、コネクタ等、電子基板・電子部品、半導体部品への各種貴金属表面処理加工を行っています。

当社は、品質を第一にお客様に信頼される製品作りを常に心がけています。また、環境活動につきましても積極的に地域貢献に取り組んでいます。

■主要設備

製造関係装置(諏訪事業所)

- プリント基板全自動電解金めっき装置
- プリント基板全自動無電解金めっき装置
- 半導体ウエハフルオート無電解めっき装置
- 半導体ウエハセミオート無電解めっき装置
- リードフレーム部分金めっき装置
- LTCC基板用無電解金めっき装置
- 電子部品用貴金属バレルめっき装置
- 総合排水処理設備

分析機器(諏訪事業所所有)

- | | |
|----------------|-----------------|
| X線光電子分光装置(XPS) | 結晶方位測定装置(EBSD) |
| 蛍光X線微小部膜厚計 | フーリエ変換赤外分光計 |
| 分光光度計 | ICP発光分光分析装置 |
| ワイアーボンダー | レーザー発信器 |
| キャピラリ電気泳動装置 | 自動滴定装置 |
| 原子吸光分光光度計 | 集束イオンビーム装置(FIB) |
| 走査型電子顕微鏡(SEM) | キャピラリ電気泳動装置 |
| FE-SEM/EDX | パーティクルカウンター |
| ボールシェアテスター | イオンミリング |
| イオンクロマトグラフィー | 透過X線装置 |

